

工业和信息化部人才交流中心  
中国高等教育学会产教融合研究分会

文件

工信人才〔2023〕34号

关于举办第二届集成电路产教融合  
高峰论坛的通知

各有关单位：

为更好推动集成电路产学合作与创新发展，工业和信息化部人才交流中心联合中国高等教育学会产教融合研究分会定于2023年4月15日在重庆市举办“第二届全国集成电路产教融合高峰论坛”。现将论坛有关事项通知如下。

一、组织架构

主办单位：工业和信息化部人才交流中心、中国高等教育学会产教融合研究分会

协办单位：重庆市半导体行业协会

承办单位：重庆西永微电子产业园区

执行承办单位：重庆海云捷迅科技有限公司

媒体单位：央视网、半导体产业纵横、芯榜、小饭桌、科钛网

运营单位：北京智芯国信科技有限公司

## 二、论坛主题

产学联动，推动集成电路创新转化与人才培养

## 三、参会人员

全国范围的集成电路院校老师，集成电路行业企业专家，行业科研创新企业代表，主管部门领导等。

## 四、论坛内容

- 1.集成电路创新转化与人才培养主论坛
- 2.专题分论坛（并行）
- 3.科研创新成果线下展会
- 4.产学合作交流闭门会议

论坛详细议程、具体地点等安排另行通知。本次论坛不收取会务费，参会者差旅自理。

## 五、报名方式

请参会嘉宾于 2023 年 4 月 5 日 23:59 前扫描下方二维码或复制下方链接到浏览器，打开《第二届全国集成电路产教融合高峰论坛》报名表，填写表单并提交。

组委会将于报名截止后，发放报名成功短信回执，请留意短信消息。

表单链接：<https://xinrenlei.mikecrm.com/6eRIavB>



## 六、联系方式

工业和信息化部人才交流中心，张老师，15120023867；  
中国高等教育学会产教融合研究分会，张老师，010-82159853；  
北京智芯国信科技有限公司，陈老师，18610321038。

附件：1.日程安排  
2.酒店推荐

工业和信息化部人才交流中心



中国高等教育学会产教融合研究分会  
(中国高等教育学会代章)

2023年3月8日



附件 1

## 日程安排

日期	时间	主题	地点
4月14日	下午	报到	融创国际 会议中心
4月15日	上午	主论坛	
	下午	集成电路院长论坛 集成电路科研创新论坛 异构加速&RISC-V海云捷迅专场论坛	
4月16日		返程	

地点：融创酒店国际会议中心（重庆市沙坪坝区文广大道18号）

## 附件 2

# 酒店推荐

### 一、重庆融创永乐半山酒店（中国重庆市沙坪坝区文广大道 18 号附 1 号）

会场内酒店，预定请拨打电话：023-8628-8888 转预订部，报参加“产教融合论坛”享受协议价 380 元/晚/单早，400 元/晚/双早。

### 二、重庆融创施伯阁酒店（中国重庆市沙坪坝区文广大道 18 号附 2 号）

会场内酒店，预定请拨打电话：023-8628-8888 转预订部，报参加“产教融合论坛”享受协议价 550 元/晚/双早。

### 三、圣荷酒店（重庆市高新区西永大道 36 号）

距离会场打车 6 公里，约 15 分钟，预定请联系张德凤经理 17783846339，报“产教融合论坛”享受协议价 398 元/晚，含单早。